

臺灣苗栗地方法院民事判決

108年度訴字第532號

原告 艾迪森光電股份有限公司

法定代理人 吳建榮

訴訟代理人 林文凱律師

複代理人 江芝聆律師

訴訟代理人 王筱君

被告 先發電光股份有限公司

法定代理人 黃登輝

訴訟代理人 馮博生律師

複代理人 游博治律師

上列當事人間請求履行契約事件，經本院於民國109年7月28日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告應給付原告新臺幣肆佰貳拾萬玖仟貳佰肆拾參元，及自民國108年12月18日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。訴訟費用由被告負擔。

本判決於原告以新臺幣壹佰肆拾萬元供擔保後，得假執行，但被告如以新台幣肆佰貳拾萬玖仟貳佰肆拾參元為原告預供擔保，得免為假執行。

事實及理由

壹、原告的主張

一、兩造約定被告先將欲委託原告加工之VCSEL晶圓產品（下稱VCSEL晶圓）售予原告（下稱合作階段A），再由原告委外加工（下稱合作階段B），加工完成後再由原告售回被告（下稱合作階段C），因此被告於民國107年8月19日向原告提出合作階段A之VCSEL晶圓報價單，其中規格850nm之晶圓12片、940nm之晶圓6片（嗣後更改為各9片），兩造並於107年8月20日簽訂「委託加工合約書」（下稱系爭契約）。

二、原告於同年11月8日向被告提出加工之報價，共計28,460美元，經被告之經理人黃慶烽表示內容沒問題，原告遂於同年

01 12月14日向被告購買「合作階段A」之VCSEL晶圓，原告完
02 成合作階段A及合作階段B後於108年2月23日以電子郵件
03 依約向被告售回完工品並請款，惟被告之業務楊子威以總經
04 理黃慶烽之權限有限等理由表示僅能給付三分之一之金額。

05 三、原告遂以存證信函催告被告給付新臺幣（下同）4,209,243
06 元【計算式：「合作階段A」之3,220,740元（ $104,400 \times$
07 美元匯率30.85 = 3,220,740）+「合作階段B」之788,06
08 3元（原報價28,460美元除加工失敗原告自行吸收之2,915
09 美元後之25,545美元 $\times$ 匯率30.85 = 788,063元）= 4,008,
10 803元，加計5%稅金後4,209,243元】，被告仍置之不理
11 。

12 四、對被告陳述之答辯

13 1.兩造於107年8月20日簽訂之系爭契約應定性為兼具承攬
14 及買賣性質之混合契約，且本件兩造顯已就「買賣標的物
15 」及「買賣價金」等買賣契約必要之點達成合致；另就承
16 攬契約之「完成一定工作」及「給付報酬」等必要之點亦
17 達成合致，簽訂系爭契約即成立且生效。另外兩造並未約
18 定將來須另訂本約，足徵兩造並無以系爭契約為預約之真
19 意，故兩造簽訂之委託系爭契約性質應為本約。本件原告
20 應完成一定工作係將被告售予原告之VCSEL晶圓交付宏捷
21 科公司加工，再將加工完成之VCSEL晶圓賣回與被告，被
22 告應給付之報酬乃依被告於合作階段A售予原告VCSEL晶
23 圓之價格加計合作階段B宏捷科公司加工費用及其他衍生
24 費用（參原證2第1條第C項），故就「完成一定工作」
25 及「給付報酬」之承攬契約必要之點，兩造亦已達成合致
26 。系爭契約已就兩造權利義務明白規範，兩造並未約定將
27 來仍須另訂本約，足徵兩造並無以系爭契約為預約之真意
28 ，是以，兩造既已就系爭契約必要之點達成合意，可作為
29 兩造將來之依據，而無再訂約之必要，其性質自應為本約
30 ，故被告將系爭契約定性為預約洵為無理。兩造亦於107
31 年12月14日履行系爭契約第1條A項，由原告向被告購買

數量為18pcs之VCSEL晶圓以供被告指定之宏捷科進行加工，被告亦出貨並開立發票予原告。

2.原告係依被告要求之晶圓製程、點測及切割等代工規格，替被告委託代工廠宏捷科科技股份有限公司（下稱宏捷科公司）進行晶圓代工。又每件代工個案皆不同，本案屬於研究開發階段之代工，非屬於一般量產階級之代工，與被告所指一般晶圓量產代工業務進行模式有異，故基於債之相對性，原告本不受被告與訴外人和光光電股份有限公司（下稱和光公司）間交易習慣約定之拘束。且被告早委請宏捷科公司代工VCSEL晶圓，於107年5月21日與宏捷科公司就加工事宜簽署保密協定，宏捷科公司並提供就被告欲進行VCSEL晶圓代工之加工製程手冊，此有被告研發部員工胡智祥與宏捷科公司研發經理薛文翔於107年5月21日、月25日電子郵件往來紀錄可資為證。

3.承上，被告於107年5月即與宏捷科公司就代工細節有所協商，不僅簽訂保密協定，宏捷科公司亦提供載有晶圓製程、點測、規格及切割等代工細節之加工製程手冊予被告，後因被告與宏捷科公司同屬晶片上游廠商，因互為競爭同業而不宜有直接交易往來，故被告委託原告並指定宏捷科公司加工VCSEL晶圓，而於107年8月19日向原告提出詳列加工製程所需之規格及數量之VCSEL晶圓報價單，委託原告作為中介代為委託宏捷科公司依被告之要求進行加工。又為取得原告營運上之支持，遂請求原告先買進欲加工之VCSEL晶圓，益徵原告於本件之主要角色係「代為委託宏捷科公司進行加工之中介」，兩造就晶圓製程、點測及切割之代工規格皆已達合意。

4.鑑於被告與宏捷科公司之競業關係並慮及保密協定等問題，未將宏捷科公司實際之報價單提供予被告，原告依委託加工合約書第1條、第2條約定，根據宏捷科公司提供之報價單加計相關費用並扣除自行吸收成本後，於107年11月8日之報價單（即原證三）詳列符合被告要求之加工款

式、數量、交貨日期及交貨地點，且原告之報價單28,460美元已獲被告董事兼總經理黃慶烽於同日簽署同意並回傳，而於108年2月23日向被告請款，被告亦同意給付部份款項，足以證明原告皆依契約履行義務。

5. 依原告經理陳宗慶（William）、被告前董事長李先華（李董）及被告前董事長楊文仁（楊董）於108年3月22日之錄音內容可證原告所述為真。

6. 又光罩係依照製程方得以設計製作，電子郵件來往紀錄可知，係由被告業務經理陳文泰先行提供製程，原告方得以依該製程請求代工製造光罩。被告礙於其與宏捷科公司同屬晶片上游廠商，互為競爭同業而不宜有直接交易往來，遂指定宏捷科公司的研發窗口及製造窗口，於107年6月14日尋求原告幫忙，請求原告與被告指定之宏捷科公司窗口聯繫加工事宜，此有被告總經理黃慶烽將被告研發部員工胡智祥與宏捷科公司研發經理薛文翔之信件往來轉寄予原告經理陳宗慶之電子郵件紀錄可資為證。

7. 再原告接受被告要求至宏捷科公司代工廠進行包括光罩及其製程之加工，同意作為「代為委託宏捷科公司進行加工」之中介，此有被告業務經理陳文泰於107年8月20日要求原告經理陳宗慶找代工廠進行加工製作的電子郵件來往紀錄可資為證：被告業務經理陳文泰107年8月20日上午9點11分：「請參考附件報價單，如果有問題的話，還請麻煩告知。另外，附上P-Sensor & 202 (1W) 的圖面給您，我這邊還有少一個，後續再補充給您。請麻煩代工廠先以2W & P-Sensor優先製作。」原告經理陳宗慶於同日上午9點20分回復：「Dear文泰哥，來信收到，但光罩的部分，我們大概會先採用蒸鍍的製程來做，所以我們預計參考"VCSEL PL01"這個蒸鍍的Design Guide來做，他總共分成6道光罩，光罩如下…所以必須在10.85 × 10.85mm的範圍內（中間有一個4mm²的Alignment Key）把6張光罩疊一下…到時候他們會把6張光罩拆開畫成4 in 1光罩

，最終光罩檔案需要是GDS檔案，謝謝。」

8.再原告鑒於被告與宏捷科公司之競業關係，並慮及保密協定等問題，未直接將宏捷科公司實際之報價單提供予被告，惟原告係依系爭契約第1條、第2條之約定根據宏捷科公司提供之報價單加計相關費用並扣除自行吸收成本後，於107年11月8日將清楚載有晶圓製程、點測、切割等加工規格及款式、數量、交貨日期、地點、價錢之報價單傳送給被告，被告總經理黃慶烽就原證3報價單上載有之資訊簽署表示同意並回傳給原告，顯見兩造就關於晶圓製程、點測及切割之代工規格皆已達成合意，被告竟將其扭曲為「僅係基於確認並確保加工費用為28,640美元之意思為之，而無從確認買賣標的物即VCSEL晶圓之加工規格」云云，未免過於牽強。

9.蓋依兩造之合意，被告先行將VCSEL晶圓售予原告（即合作階段A）之價錢為3,220,740元，而原告代為委託宏捷科進行加工加計其他衍生費用並扣除自行吸收部分之價格約823,000元（合作階段B）（宏捷科公司報價單26,680美元×30.85匯率=約823,078元），原告依約完成合作階段A、合作階段B後，請求被告依約履行合作階段C買回加工後之VCSEL晶圓卻遭被告拒絕。如合作階段A價格遠大於合作階段B加工價格，原告僅須單純以客供料加工方式花費約823,000元即可代為加工，又何必支付3,220,740元向被告購買晶片材料？以被告之總經理親筆簽回清楚載有晶圓製程、點測、切割等加工規格及款式、數量、交貨日期、地點、價錢之報價單，且無任何加註「加工規格需另行確定」或「細節另行協商」等語，足認被告已就上載所有細節和價格完全同意，才會不附任何條件代表被告簽回，被告之主張顯無足取。

10.自被告與宏捷科公司就加工事宜簽署保密協定、宏捷科公司提供就被告欲進行VCSEL晶圓代工之加工製程手冊、被告指定宏捷科公司聯絡窗口並將前開信息轉傳予原告、被

告就「合作階段A」開立發票予原告、被告總經理黃慶烽就原證3報價單上載有之資訊簽署表示同意並回傳給原告等事證，在在證明被告就關於晶圓製程、點測及切割之代工規格皆知之甚稔，原告僅按被告意思代為委託宏捷科公司公司進行加工，故兩造已達成合意。

五、原告依契約之法律關係，請求被告給付4,209,243元【計算方式；合作階段A之金額3,220,740元（104,400美元×匯率30.85＝3,220,740）、合作階段B之金額788,063元{（28,460－2,915美元）×30.85＝788,063元}，合作階段A、B金額合計4,008,803元，加計5%稅金後為4,209,243元】。並聲明：

- 1.被告應給付原告4,209,243元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率百分之5計算之利息。
- 2.如獲有利判決，原告願供擔保，請准宣告假執行。
- 3.訴訟費用由被告負擔。

貳、被告的答辯

一、兩造簽訂之系爭契約第1條係約定由被告先將欲加工之產品VCSEL晶圓銷售予原告，再由原告將VCSEL晶圓委託代工廠宏捷科公司進行晶圓加工，而非由原告自行加工，復由原告將宏捷科公司加工過之VCSEL晶圓賣回被告。系爭契約之名稱固為「委託加工合約書」，惟從VCSEL晶圓之所有權將由被告移轉予原告後（合作階段A），原告再就其所有之VCSEL晶圓委託宏捷科公司進行加工（合作階段B），復由原告將宏捷科公司加工完之VCSEL晶圓所有權移轉予被告（合作階段C）以觀，足見合作階段B係由原告就其所有之VCSEL晶圓委託宏捷科公司完成一定工作即VCSEL晶圓加工，兩造間就VCSEL晶圓加工並無承攬關係存在，是系爭契約顯然著重於經宏捷科公司加工完成後之VCSEL晶圓所有權之移轉，應適用買賣之規定。

二、系爭契約第1條僅有約定由被告先將欲加工之產品VCSEL晶圓銷售予原告，再由原告將VCSEL晶圓委託代工廠宏捷科公

01 司進行晶圓代工之代工流程，惟就欲加工之VCSEL晶圓規格
02 （包括製程、點測及切割等）、數量與金額以及宏捷科公司
03 之代工費用（包括製程、點測及切割）等契約必要之點，均
04 付之闕如，難謂已成立買賣本約。

05 三、系爭契約第1條第B項約定原告應提出之代工費用應「以宏
06 捷科公司報價單為主」，並由被告依系爭契約第2條第A項
07 就加工內容發出「採購單」，採購單上應詳列「加工款式、
08 加工數量、交貨日期和交貨地點；價格及付款條件由雙方協
09 商確定，以採購單所載為準」，可見兩造約明在簽訂系爭契
10 約之後，原告必須提出「宏捷科公司報價單」予被告，被告
11 再下達「採購單」予原告，兩造始有可能就加工規格款式、
12 加工數量、交貨日期、交貨地點、價格、付款條件等達成合
13 意而成立VCSEL晶圓買賣本約。

14 四、系爭契約僅係就VCSEL晶圓加工的實施機構（即宏捷科公司
15 ）先為預定，就欲加工之VCSEL晶圓規格、數量與金額，以
16 及宏捷科公司之製程、點測及切割等規格與代工費用，仍繫
17 於「宏捷科公司報價單」與被告「採購單」之提出，堪認系
18 爭契約僅係將來訂立VCSEL晶圓買賣本約之張本，而為買賣
19 預約，究不能因系爭契約之簽訂，即遽認買賣本約業已成立
20 。

21 五、縱使假定系爭契約之合作階段B為承攬關係，系爭契約仍為
22 承攬與買賣混合契約之預約：縱使假定原告就其所有之VCSE
23 L晶圓委託宏捷科公司進行加工前，必須提出「宏捷科公司
24 報價單」（包括晶圓製程、點測及切割等代工規格）予被告
25 ，被告再下達「採購單」予原告，宏捷科公司始得進行加工
26 ，並由原告將宏捷科公司加工完之VCSEL晶圓所有權移轉予
27 被告，而認為系爭契約對於VCSEL晶圓之加工及交付，其工
28 作之完成及財產權之移轉兩者無所偏重、輕重難分，應屬承
29 攬與買賣之混合關係，是兩造之系爭契約於VCSEL晶圓之加
30 工（合作階段B），應適用承攬之規定，於加工完成後VCSE
31 L晶圓之交付（合作階段C），應適用買賣之規定。惟兩造

01 對於合作階段B宏捷科公司如何完成一定工作即VCSEL晶圓
02 代工之規格（包括製程、點測及切割等）與報酬即代工費用
03 ，仍繫於「宏捷科公司報價單」之提出，系爭契約對於承攬
04 部分必要之點仍付之闕如，難謂承攬部分已成立本約。

05 六、系爭契約僅係就VCSEL晶圓加工的實施機構先為預定，就欲
06 加工之VCSEL晶圓規格、數量與金額，以及宏捷科公司之製
07 程、點測及切割等代工規格與代工費用，仍繫於「宏捷科公
08 司報價單」與被告「採購單」之提出，堪認系爭契約僅係將
09 來訂立VCSEL晶圓承攬與買賣混合本約之張本，而為承攬與
10 買賣混合預約，究不能因系爭契約之簽訂，即遽認承攬與買
11 賣混合本約業已成立。

12 七、依兩造簽定之系爭契約第1條約定，被告先將委託原告加工
13 之VCSEL晶圓產品售予原告，再由原告委託宏捷科公司加工
14 ，加工完成後再由原告售回被告，是系爭契約雖名為委託加
15 工合約書，惟自VCSEL晶圓之所有權由被告轉予原告後，原
16 告再將所有之VCSEL晶圓委託宏捷科公司加工後由原告
17 將宏捷科公司加工完之VCSEL晶圓所有權移轉給予被告觀之
18 ，合作階段B係由原告就其所有權之VCSEL晶圓委託宏捷科
19 公司加工完成一定之工作，兩造間就VCSEL晶圓加工並無承
20 攬關係存在，顯然著重於經宏捷科公司完工後之VCSEL晶圓
21 所有權之移轉，應適用買賣之規定。縱然認定系爭契約書之
22 合作階段B為承攬關係，系爭契約仍為承攬與買賣契約之預
23 約。

24 八、承上，兩造於合作階段B兩造間就VCSEL晶圓加工並無承攬
25 關係存在，且系爭契約第1條未就欲加工之VCSEL晶圓規格
26 （包括製程、點測及切割等）、數量與金額以及宏捷科公司
27 之代工費用（包括製程、點測及切割）等契約必要之點未約
28 定，原告需提出「宏捷科公司報價單」予被告，被告再下達
29 「採購單」予原告，兩造始有可能就加工規格款式、加工數
30 量、交貨日期、交貨地點、價格、付款條件等達成合意而成
31 立VCSEL晶圓買賣本約，惟原告於107年11月8日提出之「

01 Quotatio n」係以原告「Edison OptoCorporati on」名義
02 提出，並非宏捷科公司報價單，縱認係由宏捷科公司公司提
03 出之報價單，被告亦從未與宏捷科公司正式確認VCSEL晶圓
04 代工規格，該報價單亦無相關規格，原告亦未曾予被告討論
05 代工之需求等，自難認兩造就買賣必要之點達成合致，故系
06 爭契約僅係將來訂立VCSEL晶圓買賣本約之張本，為買賣預
07 約。假使認定系爭契約之合作階段B為承攬關係，系爭契約
08 仍為承攬與買賣混合契約之預約，然被告總經理黃慶烽於10
09 7年11月8日回簽系爭報價單僅係確認加工費用為28,640美
10 元之意思，並非下達採購單。

11 九、綜上，無論系爭契約之性質究屬買賣或承攬與買賣混和契約
12 ，系爭契約僅就VCSEL晶圓加工實施機構先為預定，關於系
13 約之必要之點均付之闕如，堪認系爭契約僅係將來訂立買賣
14 本約獲承攬與買賣契約混合本約之張本，仍為預約，不能因
15 系爭契約之簽定，即認本約已成立。兩造間僅為買賣預約，
16 原告不得要求被告履行買賣本約之付款義務，縱認系爭契約
17 為買賣預約，原告提出者非宏捷科公司之報價單，且該報價
18 單亦無代工規格，難謂已依債之本旨履行買賣本約之義務，
19 被告自得拒絕給付價金。退步言，縱然認定系爭報價單係由
20 宏捷科公司提出，系爭報價單因欠缺VCSEL晶圓規格（包括
21 製程、點測及切割）等買賣本約之必要之點，兩造間仍未成
22 立本約，而僅成立買賣之預約。又無論是研究開發階段或一
23 般晶圓量產階段，均應VCSEL晶圓加工規格及品質標準認定
24 ，原告辯稱本件屬於研究開發階段之代工，無固定之產品規
25 格及品質標準認定，與被告提出和光光電公司之一般晶圓代
26 工業務進行模式有異，應無可採。

27 十、系爭契約第1條第B項與第2條第A項已約明在簽訂系爭契
28 約後，原告必須先提出「宏捷科公司報價單」之書面要式予
29 被告，被告再下達「採購單」予原告，兩造始有可能就加工
30 款式、加工數量等達成合意而成立VCSEL晶圓買賣本約。惟
31 原告於107年11月8日向被告提出之「Quotation」（原證

3) (下稱「系爭報價單」) 係以原告「Edison OptoCorporation」名義提出，並非「宏捷科公司報價單」，系爭報價單內亦無任何「宏捷科公司」之字樣，且原告從未提出任何「宏捷科公司報價單」予原告，故原告既未履行系爭契約第1條第B項之義務，兩造間因欠缺約定之書面要式，故未成立買賣本約，而仍僅有成立系爭契約此一買賣預約，原告辯稱系爭報價單已符合系爭契約第1條之約定云云（原告民事準備（一）狀第8頁第9行至第10行），實屬無稽。

十一、退步言之，縱使假定系爭報價單係由宏捷科公司提出，系爭報價單因欠缺VCSEL晶圓代工規格（製程、點測及切割）等買賣本約必要之點，故兩造間仍未成立買賣本約，而僅成立買賣預約：原告既主張被告早於107年8月20日兩造簽訂系爭契約前，即與宏捷科公司就VCSEL晶圓代工之製程、點測及切割等代工規格有所磋商協議，始尋求原告作為中介代為委託並指定宏捷科公司進行加工云云（原告民事準備（一）狀第7頁第22行至第8頁第4行），則原告自應就被告與宏捷科公司就VCSEL晶圓之製程、點測及切割等代工規格已為正式確認且已達成意思合致，負舉證之責，惟原告並未提出任何證據以實其說，顯難採信。

十二、業界就關於850nm、940nm之VCSEL晶圓加工規格會定義產出的芯片（chip）經過驗證後電壓、電流、波長應達到一定之標準規格，並告知濕氧化製程條件（Oxidation test），經同意後始進行加工。惟系爭報價單表所載資訊僅有VCSEL晶圓款式的代工價格說明，實無芯片經過驗證後電壓、電流、波長應達到一定之標準與濕氧化製程條件等VCSEL晶圓製程、點測及切割之代工規格，此觀系爭報價單自明。是以，原告辯稱系爭報價單上已記載VCSEL晶圓之晶片款式、加工款式及加工數量，並獲被告總經理黃慶烽簽名回傳，顯見被告就VCSEL晶圓製程、點測及切割等代工規格已進行確認云云（原告民事準備（一）狀第8頁第17行至第9頁第2行），顯屬混淆視聽之詞，自不足採

01 。

02 十三、VCSEL 晶圓代工業務進行模式不論是研究開發階段或是一
03 般晶圓量產階段，被告均是提供VCSEL 晶圓供購買之客戶
04 進行下階段製程，若屬研究開發階段，購買VCSEL 晶圓之
05 客戶會依VCSEL 晶圓結構進行光罩設計，並提供予加工廠
06 商（如宏捷科公司）進行代工製程；若屬一般晶圓量產階
07 段，則是依加工廠商自有光罩設計，直接使用被告之VCSEL
08 L 晶圓進行代工製程，惟不論是研究開發階段或是一般晶
09 圓量產階段，均應有VCSEL 晶圓規格及品質標準認定。是
10 以，原告辯稱本件屬研究開發階段之代工，無固定之產品
11 規格及品質標準認定，亦與被告於答辯（一）狀提出與和
12 光公司之一般晶圓量產代工業務進行模式有異云云（原告
13 民事準備（一）狀第6頁第2行至第16行、第9頁第10行
14 至第12行），實屬蓄意誤導，要無可採。

15 十四、系爭契約第1條第B項約定：「說明：宏捷科公司將視實
16 際代工的需求，切出晶片大小及樣式…」，第2條第C項
17 復約定：「因本合約為量產前之測試加工訂單，無論最終
18 加工產品良率多少，甲方（即被告）不得以良率不佳拒絕
19 付款買回。」綜觀上開條文，由於被告不論加工後VCSEL
20 晶圓之良率為何均不得拒絕付款買回，亦徵前階段實際代
21 工需求之確認，亦即製程、點測及切割等代工規格之確認
22 及合意，將更顯重要，故宏捷科公司必須依被告之需求對
23 原告所有之VCSEL 晶圓執行加工作業，原告再將加工後之
24 VCSEL 晶圓賣回被告，原告始得主張被告不得以良率不佳
25 拒絕買回VCSEL 晶圓。惟原告不僅未提出「宏捷科公司報
26 價單」，原告所提出之系爭報價單亦無VCSEL 晶圓製程、
27 點測及切割等代工規格，原告更未曾與被告討論本件代工
28 之需求如VCSEL 晶圓加工後的芯片電壓、電流、波長應達
29 到何種規格、光罩（配合濕氧化製程條件）該如何設計等
30 ，故原告辯稱其交付宏捷科公司加工之晶圓製程流程作業
31 等代工要求被告知之甚稔，故兩造方於系爭契約約定無論

01 宏捷科公司之產出良率為何被告都必須支付費用云云（原
02 告民事準備（一）狀第9頁第12行至第17行），自無依憑
03 ，委不可採。

04 十五、被告總經理黃慶烽雖於107年11月8日回簽報價單，兩造
05 間仍未成立買賣本約，而僅成立買賣預約：按系爭契約第
06 1條第B項與第2條第A項約定，原告必須提出「宏捷科
07 公司報價單」之書面要式予被告，被告再下達「採購單」
08 之書面要式予原告，兩造始有可能就加工款式、加工數量
09 等達成合意而成立VCSEL晶圓買賣本約。經查，系爭報價
10 單欠缺VCSEL晶圓製程、點測及切割等買賣本約必要之點
11 已如前述，被告總經理黃慶烽雖於107年11月8日回簽系
12 爭報價單，僅係基於確認並確保加工費用為28,640美元之
13 意思為之，而無從確認買賣標的物即VCSEL晶圓之加工規
14 格，自難認兩造間就買賣契約必要之點已達成合致。則原
15 告辯稱系爭報價單已獲被告總經理黃慶烽簽名回傳，顯見
16 被告就VCSEL晶圓製程、點測及切割等代工規格再次進行
17 確認云云（原告民事準備（一）狀第8頁第23行至第9頁
18 第2行），顯屬誤會，並無足取。

19 十六、本件原告於107年11月8日提出之系爭報價單並非「宏捷
20 科公司報價單」，被告在原告於108年2月23日寄送電子
21 郵件表示已完成委託VCSEL晶圓代工前，亦未曾向原告下
22 過任何「採購單」，不符合系爭契約約定之形式要件，表
23 示被告並未向原告發出任何可以委託宏捷科公司進行代工
24 之訊息。再者，原告提出之系爭報價單既未記載系爭契約
25 第1條B項約定之VCSEL晶圓「製程、點測及切割」等系
26 爭契約約定之實質要件，縱使被告總經理黃慶烽於107年
27 11月8日回簽系爭報價單，亦難認被告對代工規格此一實
28 質要件已與原告有意思表示合致而實質上符合系爭契約第
29 2條A項之實質要件，故難謂其已依系爭契約履行義務。
30 又一般晶圓代工業務進行中，若無詳細規格內容，簽回對
31 方報價單僅係綁定項目價格，而非確認規格，難謂兩造就

完成一定工作之內容已達意思合致。被告與訴外人和光光電股份有限公司之代工業務進行，就是委由代工方與代工方溝通晶圓製程、點測及切割等內容，確認規格報價單，再由委託方提出採購單表示委託代工方對於加工款式、數量等內容之需求。被告於107年11月8日簽回原告之報價單即無上開流程等代工規格。被告總經理黃慶烽雖於107年11月8日回簽系爭報價單，僅係基於確認並確保加工費用為28,640美元之意思為之，況被告在原告於108年2月23日寄送電子郵件表示已完成委託VCSEL晶圓代工前，亦未曾向原告下過任何「採購單」，亦不符合系爭契約約定之形式要件，故無從認為被告總經理黃慶烽於107年11月8日回簽系爭報價單得取代系爭契約約定應由被告下達之採購單。準此，兩造間就買賣本約必要之點之意思表示仍未達成合致，故兩造間仍未成立買賣本約，而僅有成立系爭合約此一買賣預約。

十七、原告未依系爭契約第1條第B項提出「宏捷科公司報價單」，故兩造間仍未成立買賣本約。退步言之，縱使假定系爭報價單係由宏捷科公司提出，系爭報價單因欠缺VCSEL晶圓製程、點測及切割等代工規格，故兩造間就買賣本約必要之點之意思表示仍未達成合致，無從解為已成立買賣本約。又被告總經理黃慶烽雖基於確認並確保加工費用為28,640美元之意思於107年11月8日回簽系爭報價單，仍無從取代系爭契約約定應由被告下達「採購單」之要式行為。因此，兩造間仍未成立買賣本約，而僅有成立系爭合約此一買賣預約。是原告依系爭契約請求被告給付新台幣4,209,243元，應無理由。

十八、並為答辯之聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。

參、兩造不爭執事項

一、被告於107年8月19日出具報價單記載「規格描述940nm VCSEL Epi Wafer (6Inch)、6pcs、單價美元(下同)」

5800、金額 34800 ；850nm VCSEL Epi Wafer (6Inch)
12pcs 、單價 5800、金額 69600 。TOTAL 104,400 ，交期：
A .R .O .4Weeks ，付款方式 100%月結 30天」 (竹院卷 19頁) 。

二、兩造於 107 年 8 月 20 日簽訂委託加工合約書。甲方即被告先發公司委託乙方即原告艾笛加工 VCSEL 晶圓產品 (下稱 VCSEL 晶圓) 售予原告 (下稱合作階段 A) ，再由原告委外加工 (下稱合作階段 B) ，加工完成後再由原告售回予被告 (下稱合作階段 C) 。

三、委託加工合約書第一條代工項目、價格與說明

A 由甲方 (即被告) 先將欲加工之產品 VCSEL 晶圓銷售予乙方 (即原告) ，再由乙方將前述產品提供給代工廠宏捷科公司進行晶圓代工。

B 宏捷科公司之晶圓代工費用包括晶圓製程、點測及切割，實際報價以宏捷科公司報價單為主。

說明：宏捷科公司將視實際代工的需求，切出晶片的大小及樣式，而衍生光照費用 (4 合一光罩) ，包含一式兩張光罩及單片晶圓代工費用。惟單一樣式與大小的晶片，最少投入數量為 3PCS，此 3PCS 中有 1PCS 需作為氧化製程條件之前導片，而此前導片不會有產出。

C 代工價格：待乙方完成前述 A 、B 兩項代工項目後，乙方 (即原告) 將所有加工過之物料賣回甲方 (即被告) ，賣回價格包含前述 A 、B 項費用以及其他實際發生之衍生費用，因本合約之代工產品為量產前之測試品，雙方同意無論宏捷科公司之產出良率為何，甲方都必須支付上述 A 與 B 兩項及其他衍生費用予乙方。 (竹院卷 21 頁)

四、委託加工合約書第二條內容及程序

A 甲方 (即被告委託乙方 (即原告) 為其加工的內容，以採購單的形式發出，採購單上應詳列加工款式、加工數量、交貨日期和交貨地點；價格及付款條件由雙方協商確定，

01 以採購單所載為準。

02 B 甲方依其自主判斷下達採購單給乙方，乙方應於進行書面
03 確認回覆。如果乙方在三個工作日內對採購單無回應，
04 則視為接受。

05 C 因本合約為量產前之測試加工訂單，無論最終加工產品
06 良率多少，甲方不得以良率不佳拒絕付款買回。

07 五、委託加工合約書 第五條 違約責任

08 A 因不可歸責於乙方之因素，若甲方未依議定之時間付款，
09 應按需付款當時之台灣銀行。

10 B 任一方違反本合約約定的，未違約方得終止或解除本合約
11 ，違約方應賠償未違約方所受之損失。

12 六、委託加工合約書第六條 其他

13 A 本合約中一方給對方的通知可以書面形式通過郵寄、傳
14 真 或電子郵件發送或傳輸到對方規定的地址。通知包括
15 合約下任何確認、意見、同意、指示、命令和書面報告
16 等。B 未盡事宜雙方友好協商解決。

17 七、原告陳宗慶於107年11月8日以mail提出原告委託加工之報
18 價，共28,460美元，請烽哥查閱附件報價，並請回簽。被告
19 總經理黃慶烽回覆此內容沒問題，再麻煩你處理後續作業，
20 因我人在台北，回簽的檔案晚點補簽（竹院卷31、33頁）。

21 八、原告於107年12月14日出貨單向被告購買合作階段A之VCSE
22 L晶圓，共104,400美元，由翁尚閣簽收，並開立00000000
23 號發票。（竹院卷35-37頁）

24 九、原告寄發代工費用及出貨明細的郵件向被告表示已完成委託
25 代工之18PCS VCSEL wafer晶圓，匯率以原告18PCS匯款給
26 被告的結算日為準。（竹院卷39頁）

27 十、兩造對於卷41-47頁的對話內容不爭執。

28 十一、原告於108年4月25日以中和郵局存證號碼000287之存證
29 信函略以：請被告先發公司於文到後7日內支付貨款新臺
30 幣4,209,243元；原告艾笛森公司已於107年8月18日依
31 合約購入被告之晶圓物料共計3,220,740元，被告先發公

01 司亦於同年11月8日同意宏捷科公司之晶圓代工費及原告
02 於108年2月23日完成產品及交付產出報告，共計費用為
03 788,063元，總金額為4,008,803元，加計5%稅後被告應
04 給付原告4,209,243元，並請支付上述貨款，若逾期未收
05 到貨款，將循法律途徑等語（竹院卷49-59頁）。

06 肆、本院之判斷

07 一、被告於107年8月19日出具報價單記載「規格描述940nm
08 VCSEL Epi Wafer（6Inch）、6pcs、單價美元（下同）
09 5800、金額34800；850nm VCSEL Epi Wafer（6Inch）
10 12pcs、單價5800、金額69600。TOTAL 104,400，交期：
11 A.R.O.4Weeks，付款方式100%月結30天」，兩造因此於
12 107年8月20日簽訂委託加工合約書。被告委託原告加工
13 VCSEL晶圓售予原告即合作階段A，再由原告委託代工廠宏
14 捷科公司加工即合作階段B，加工完成後再由原告售回被告
15 即合作階段C等情，有「合作階段A」之VCSEL晶圓報價單
16 （竹院卷19頁）、委託加工合約書（竹院卷21-25頁）等影
17 本可憑，且為兩造所不爭執，堪認為真實。

18 二、原告主張其向被告提出加工之報價，共計28,460美元，被告
19 之經理人黃慶烽表示內容沒問題，原告遂向被告購買「合作
20 階段A」之VCSEL晶圓，原告完成合作階段A及合作階段B
21 後於108年2月23日以電子郵件依約向被告售回完工品並請
22 款，惟被告之業務楊子威以總經理黃慶烽之權限有限等理由
23 表示僅能給付三分之一之金額。原告以存證信函催告被告給
24 付價金4,209,243元而未獲付款等情，為被告所否認，辯稱
25 兩造僅簽訂預約，未簽本約。其未曾取得宏捷科公司之報價
26 單，也未與原告確認晶圓製程、點測及切割之規格，原告違
27 反委託加工合約書第1條、第2條之約定，故原告以其自行
28 與第三人完成之加工品要求被告履行契約付款義務委無可採
29 ，云云，經查：

30 1.按兩造簽訂之系爭契約第1條約定略以「甲方即被告先將
31 欲加工之產品VCSEL晶圓銷售予乙方即原告，再由原告將

前述產品提供給代工廠宏捷科公司進行晶圓代工。宏捷科公司之晶圓代工費用包括晶圓製程、點測及切割，實際報價以宏捷科公司報價單為主。並說明宏捷科公司將視實際代工的需求，切出晶片的大小及樣式，而衍生光照費用（4合一光罩），包含一式兩張光罩及單片晶圓代工費用。惟單一樣式與大小的晶片，最少投入數量為3PCS，此3PCS中有1PCS需作為氧化製程條件之前導片，而此前導片不會有產出。原告完成前述A、B兩項代工後，原告將所有加工過之物料賣回被告，賣回價格包含前述A、B項費用以及其他實際發生之衍生費用，因本合約之代工產品為量產前之測試品，雙方同意無論宏捷科公司之產出良率為何，被告都必須支付上述A與B兩項及其他衍生費用予原告。」等節，可知：

(一)原告向被告採購原料後，交給代工廠宏捷科公司加工後賣回給被告，宏捷科公司之晶圓代工費用包括晶圓製程、點測及切割，無論宏捷科公司之產出良率如何，被告都必須支付上述合作階段A與B兩項及其他衍生費用予原告，並無被告所抗辯其要先自原告處取得宏捷科公司之報價單，其先要與原告確認宏捷科公司晶圓製程、點測及切割規格等項之約定。是被告主張原告需提出「宏捷科公司報價單」，被告再下達「採購單」予原告，兩造始有可能就加工規格款式、加工數量、交貨日期、交貨地點、價格、付款條件等達成合意而成立VCSEL晶圓買賣本約等情，除於兩造簽訂系爭契約內並未見被告所主張的文字記載外，系爭契約第1條B項尚記載「宏捷科公司將視實際代工的需求，切出晶片的大小及樣式，而衍生光照費用（4合一光罩），包含一式兩張光罩及單片晶圓代工費用。惟單一樣式與大小的晶片，最少投入數量為3PCS，此3PCS中有1PCS需作為氧化製程條件之前導片，而此前導片不會有產出。」等說明細節，如兩造未就交付宏捷科公司加工之產品VCSEL晶圓達成共識

01 ，原告如何依系爭契約向被告採購多少的原料？宏捷科
02 公司如何出具報價單？何以有說明記載「切出晶片的大
03 小及樣式…單一樣式與大小的晶片，最少投入數量為
04 3PCS，此3PCS中有1PCS需作為氧化製程條件之前導片」
05 等細節？如何約定無論宏捷科公司加工產品良率被告均
06 會買回？被告所辯與經驗法則不符。堪認本件兩造並無
07 約定「原告需提出宏捷科公司報價單，被告再下達採購
08 單予原告」之情節，系爭契約即為買賣VCSEL晶圓之本
09 約，約定內容為「合作階段A、B、C」VCSEL晶圓之
10 購買、加工、賣回，其餘均應係被告臨訟編纂之詞，難
11 認為真。

12 (二)被告於107年8月19日出具的報價單已記載「規格描述
13 000nmVCSEL Epi Wafer (6Inch)、6pcs、單價美元 (
14 下同) 5800、金額34800；850nm VCSEL Epi Wafer (
15 6Inch) 12pcs、單價5800、金額69600。TOTAL
16 104,400，交期：A .R .O .4Weeks，付款方式100%月
17 結30天」等項，堪認兩造就原告向被告購買原料，要求
18 代工廠宏捷科公司之加工，有所討論達成共識後，被告
19 方出具出貨單，否則原告何冒風險向被告購買合作階段
20 A之VCSEL晶圓，再於系爭契約約定轉委託宏捷科公司
21 代工後無論良率與否均賣回被告？因此被告辯稱「原告
22 於107年11月8日提出之『Quota tio n』係以原告『
23 Edison Opto Corporation』名義提出，並非宏捷科公
24 司報價單，顯與經驗法則不符。又被告主張兩造簽訂之
25 系爭契約不是買賣本約，而是買賣之預約或買賣與承攬
26 混和之預約，則被告如何依系爭契約之預約知悉如何出
27 貨給原告，再由原告將所購買VCSEL晶圓原料交付宏捷
28 科公司加工？何況原告承辦員陳宗慶與被告公司董事長
29 李先華、副董事長陳發慈、總經理黃慶烽、業務經理陳
30 文泰等人已協商討論（詳卷279頁即原證16電子郵件、
31 卷323-325頁即原證18陳宗慶與陳文泰對話紀錄）。另

01 原告委託宏捷科公司代工之晶圓代工費用包括晶圓製程
02 、點測及切割，應係原告交付給被告合作階段C時所交
03 付之產品是否符合被告與原告當初約定代工之「晶圓製
04 程、點測及切割」物之瑕疵問題，應與107年8月20日
05 簽訂已成立之系爭契約無涉。被告並未舉證原告交付合
06 作階段C之產品VCSEL晶圓有不符合被告之要求，是被
07 告主張原告違反系爭契約第1條、第2條之約定，並不
08 可採。

09 (二)另被告係與原告簽訂系爭契約，並非與宏捷科公司簽訂
10 加工契約，被告如何與代工廠宏捷科公司正式確認VCS
11 EL晶圓之規格？是被告辯稱要與代工廠宏捷科公司確認
12 VCSEL晶圓之規格，亦不足採。又系爭契約亦未約定原
13 告必須提出宏捷科公司報價單後，被告方對原告下採購
14 單。是被告辯稱其未與宏捷科公司正式確認VCSEL晶圓
15 代工規格，該報價單亦無相關規格，原告亦未曾與被告
16 討論代工之需求，自難認兩造就買賣必要之點達成合致
17 ，系爭合約書僅係將來訂立VCSEL晶圓買賣本約之張本
18 ，為買賣預約等節，與原告已向依系爭契約被告購料完
19 成合作階段A之事實不符，應不可採。

20 2.另依系爭契約第2條約定「A 甲方即被告委託乙方即原告
21 為其加工的內容，以採購單的形式發出，採購單上應詳列
22 加工款式、加工數量、交貨日期和交貨地點；價格及付款
23 條件由雙方協商確定，以採購單所載為準。B 甲方依其自
24 主判斷下達採購單給乙方，乙方應於進行書面確認回覆。
25 如果乙方在三個工作日內對採購單無回應，則視為接受。
26 C 因本合約為量產前之測試加工訂單，無論最終加工產品
27 良率多少，甲方不得以良率不佳拒絕付款買回。」可知，
28 原告承辦員陳宗慶於107年11月8日以mail提出原告委託
29 加工之報價，共28,460美元，請被告總經理黃慶烽查閱附
30 件報價，並請回簽。被告總經理黃慶烽回覆「此內容沒問
31 題，再麻煩你處理後續作業，因我人在台北，回簽的檔案

01 晚點補簽」等情（詳竹院卷31、33頁mail），可知本件原
02 告於107年12月14日出具出貨單向被告購買合作階段A之
03 VCSEL晶圓，共104,400美元，由翁尚閣簽收，並有其開
04 立發票可證（詳竹院卷35-37頁），符合系爭契約第2條
05 A之約定，堪認原告主張為真實。另自107年10月24日原
06 告承辦員陳宗慶對被告承辦員黃慶烽表示「烽哥，AWSC報
07 價8mil process做到好有點貴，9400usd/pcs，我需要確
08 認一下」等情（卷327-329頁即原證19陳宗慶與黃慶烽對
09 話），可明原告知宏捷科公司報價後曾與被告承辦員黃慶
10 烽討論（亦即雙方已談到代工完成後價格「有一點貴」）
11 ，顯然兩造就宏捷科公司之報價有所知悉，否則如何知道
12 加工完成「有一點貴」？被告並非全然不詳宏捷科公司之
13 報價，既然被告知悉宏捷科公司之報價，當然兩造就合作
14 階段B之VCSEL晶圓製程、點測及切割有所協商，否則宏
15 捷科公司依何項目報價給原告？原告如何依系爭契約報價
16 給被告？且原告已寄發代工費用及出貨明細的郵件向被告
17 表示已完成委託代工之18PCS VCSEL wafer晶圓，匯率以
18 原告18PCS匯款給被告的結算日為準（竹院卷39頁），如
19 被告不同意原告合作階段C之出貨及報價，兩造應於履約
20 期間彼此有所催告或在往來Mail中有所討論，然被告未曾
21 舉證何以履約期間其同意給付3分之1貨款給原告（竹院
22 卷第41頁原證6），而不同意給付其他產品款項之事證，
23 就委託宏捷科公司加工之VCSEL晶圓製程、點測及切割，
24 有所質疑？被告辯稱其總經理黃慶烽於107年11月8日回
25 簽系爭報價單僅係確認加工費用為28,640美元之意思，並
26 非下達採購單云云，顯與一般經驗法則相違背，而不可採
27 。又本件僅原告於108年4月25日以中和郵局存證號碼
28 287之存證信函催告被告於文到後7日內支付貨款4,209,
29 243元（詳竹院卷49-59頁），未見履約期間被告對原告
30 就合作階段C之出貨、報價有何爭論之文件往來，故被告
31 辯稱其不知道宏捷科公司的報價，未下訂單，為不可採。

01 反依兩造對話知悉「應是被告董事長卸任，組織改組而沒
02 人願意處理，只願意收原告的小功率PO貨，並通知出貨」
03 而拒絕給付被告所請求款項（詳竹院卷46-47頁對話），
04 方為真實。

05 三、另按系爭契約第5條「1.因不可歸責於乙方之因素，若甲方
06 未依議定之時間付款，應按需付款當時之台灣銀行。2.任一
07 方違反本合約約定的，未違約方得終止或解除本合約，違約
08 方應賠償未違約方所受之損失。」約定，原告可按付款當時
09 台灣銀行之新台幣兌換美元之匯率請求被告給付貨款。本件
10 有被告總經理黃慶烽簽署同意之「合作階段B」加工報價單
11 、（竹院卷27-33頁）、被告出貨予原告之出貨單暨發票影
12 本（竹院卷35-37頁）、原告履行「合作階段C」後通知被
13 告之電子郵件（竹院卷39頁）、原告公司經理陳宗慶與被告
14 公司業務之WeChat對話記錄（竹院卷41頁），足認本件原告
15 已於107年8月18日依合約購入被告之晶圓物料共計3,220,
16 740元，被告亦於同年11月8日同意宏捷科公司之晶圓代工
17 費，及原告於108年2月23日完成產品及交付產出報告，共
18 計費用為美金788,063元，匯率以原告18PCS匯款給被告的
19 結算日為準（竹院卷39頁），總金額為4,008,803元，加計
20 5%稅後被告應給付原告4,209,243元【計算式：「合作階段
21 A」之3,220,740元（ $104,400 \times 30.85 = 3,220,$
22 740 ）+「合作階段B」之788,063元（原報價28,460美
23 元除加工失敗原告自行吸收之2,915美元後之25,545美元 $\times$
24 匯率30.85 = 788,063元）= 4,008,803元，加計5%稅金
25 後4,209,243元】。是原告依系爭契約請求被告給付4,209,
26 243元，有所依據。

27 四、未按給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責
28 任。給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經
29 其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權
30 人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他
31 相類之行為者，與催告有同一之效力。民法第229條第1項

01 及第2項分別定有明文。又遲延之債務，以支付金錢為標的
02 者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率
03 較高者，仍從其約定利率。應付利息之債務，其利率未經約
04 定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5。民法第233條
05 第1項及第203條定有明文。原告對被告之履行契約請求權
06 ，由兩造協商確定，以採購單所在為準（即100%月結30天，
07 竹院卷第21頁、第19頁），係屬於有定給付期限之金錢債權
08 ，然本件原告以起訴狀之繕本送達翌日作為請求之起算日，
09 而本件民事訴訟起訴狀繕本係於108年12月17日送達被告，
10 有本院送達證書在卷可查（本院卷第41頁），則原告請求自
11 民事訴訟起訴狀繕本送達之翌日即108年12月18日起至清償
12 日止，均按年息百分之5計算之利息，洵屬有據，應予准許
13 。

14 五、綜上所述，兩造於107年8月20日簽訂系爭契約成立有效的
15 買賣契約。原告並於107年8月18日依系爭契約購入被告之
16 晶圓物料共計3,220,740元，亦即被告確依107年8月20日
17 簽訂系爭契約先將欲加工之產品VCSEL晶圓銷售予原告，數
18 量為3,220,740元。原告依系爭契約並無必須先提供宏捷科
19 公司之報價單給被告知悉之義務。兩造也已先就宏捷科公司
20 晶圓代工之晶圓製程、點測及切割等規格，有所協商後，方
21 有合作階段A、B、C之履約，亦即兩造是先達成VCSEL晶
22 圓規格後提供給代工廠宏捷科公司進行晶圓代工，並與宏捷
23 科公司之晶圓製程、點測及切割有所協商達成共識後，原告
24 方向被告購買VCSEL晶圓原料委託宏捷科公司代工，無論宏
25 捷科公司加工後是否良率全部賣回被告，且被告亦於往來文
26 件同意給付3分之1貨款。被告並未舉證原告交付合作階段
27 C之產品，未符系爭契約約定之規格，反依兩造對話知悉係
28 因被告公司組織改組，被告因此拒絕給付款項，故原告於10
29 7年3月18日要求被告買回VCSEL晶圓，被告拒絕付款，為
30 無理由。原告依系爭契約關係，請求被告給付原告4,209,24
31 3元，及自起訴狀繕本送達之翌日起即108年12月18日起至

01 清償日止，按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准
02 許。又兩造均陳明願供擔保，聲請宣告假執行或免為假執行
03 爰分別酌定相當擔保金額准許之。

04 六、本件判決之基礎已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法、所提
05 證據及聲請調查之證據，均經斟酌，核與判決之結果不生影
06 響，爰不一一論述，因此被告於109年7月28日遞狀聲請再
07 開辯論，亦無必要，附此敘明。

08 七、訴訟費用之依據：民事訴訟法第78條。

09 中 華 民 國 109 年 8 月 11 日
10 民事第一庭 法官 張珈禎

11 以上正本係照原本作成。

12 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（須
13 附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

14 中 華 民 國 109 年 8 月 11 日
15 書記官 廖仲一